

CSD95430RRB 同期整流降圧型 NexFET™ スマート出力段

1 特長

- 単一の PWM 入力を共有する並列位相間のアクティブ電流バランス
- ピーク連続電流: 90A
- システム効率: 30A 時に 95% 超
- 高周波動作: 1.25MHz
- ダイオード・エミュレーション機能により、効率的な不連続モード (DCM) 動作が可能になります
- 温度補償双方向電流センス
- アナログ温度出力
- フォルト監視
- PWM 信号互換: 3.3V、5V
- トライステート PWM 入力
- ブートストラップ・スイッチ内蔵
- 貫通電流を防止するように最適化されたデッドタイム
- 業界で一般的な高密度 QFN 5mm x 6mm フットプリント
- インダクタンスが非常に低いパッケージ
- システム最適化 PCB フットプリント
- 放熱性に優れたトップサイド冷却
- RoHS 準拠 — 鉛フリーの端子メッキ処理
- ハロゲン不使用

2 アプリケーション

- マルチフェーズの同期整流降圧コンバータ
 - 500A 超
 - 高周波
- メモリ・カードおよびグラフィック・カード
- データ・センターおよびネットワーク・スイッチ
- キャンパス / 分岐スイッチ
- コア / エッジ・ルータ
- ハードウェア・アクセラレータ・カード
- 高性能 CPU/ASIC/FPGA 電源

3 概要

CSD95430RRB NexFET™ 出力段は、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品はドライバ IC とパワー MOSFET を統合することにより、出力段スイッチング機能を実現しています。この組み合わせは、5mm × 6mm という小型のパッケージで大電流、高効率、高速のスイッチングに対応します。また、正確な電流センシングおよび温度センシング機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。さらに、設計期間を短縮し、システム全体の設計を簡素化できるように、PCB の占有面積を最適化しています。この出力段にはアクティブ電流バランス機能があり、単一の PWM 入力で複数の出力段を並列接続できます。これにより、同様に高い位相数のコントローラを必要とせず、超大電流アプリケーションで位相乗算を実行できます。アクティブ電流バランスにより、乗算された位相が電流を均等に共有するため、並列位相時に電流能力の大幅なディレーティングは必要ありません。

デバイス情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	本体サイズ (公称)
CSD95430RRB	VQFN-CLIP	5.00mm × 6.00mm

(1) 利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

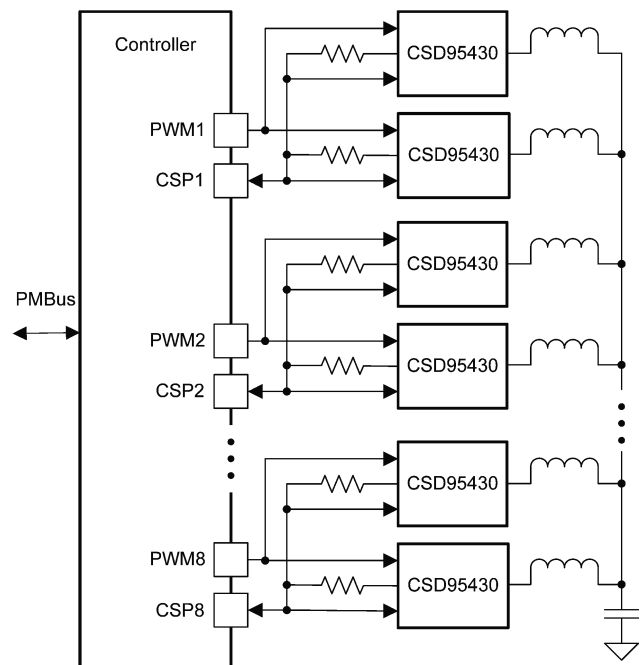


Table of Contents

1 特長	1	6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information	4
2 アプリケーション	1	6.1 Package Option Addendum.....	5
3 概要	1	6.2 Tape and Reel Information.....	6
4 Revision History	2	6.3 Mechanical Drawing.....	7
5 Device and Documentation Support	3	6.4 Recommended PCB Land Pattern.....	8
5.1 Documentation Support.....	3	6.5 Recommended Stencil Opening.....	9
5.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	3	6.6 Alternate Industry Standard Compatible PCB Land Pattern.....	10
5.3 サポート・リソース.....	3	6.7 Alternate Industry Standard Compatible Stencil Opening.....	11
5.4 Trademarks.....	3		
5.5 静電気放電に関する注意事項.....	3		
5.6 用語集.....	3		

4 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

DATE	REVISION	NOTES
January 2023	*	Initial release

5 Device and Documentation Support

TI offers an extensive line of development tools. Tools and software to evaluate the performance of the device, generate code, and develop solutions are listed below.

5.1 Documentation Support

5.1.1 Related Documentation

5.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[ti.com](https://www.ti.com) のデバイス製品フォルダを開いてください。「更新の通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

5.3 サポート・リソース

[TI E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の[使用条件](#)を参照してください。

5.4 Trademarks

NexFET™ and TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

5.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

5.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

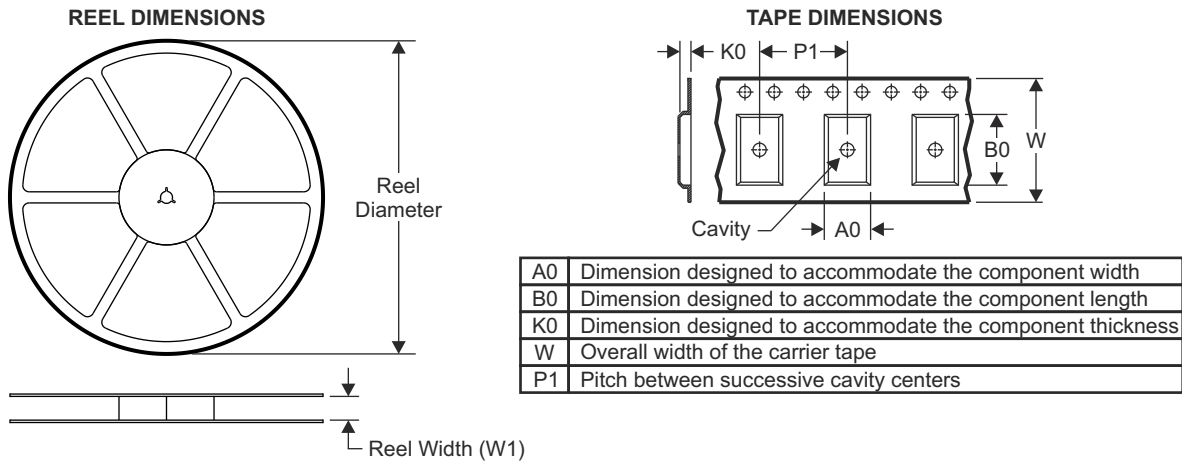
The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

6.1 Package Option Addendum

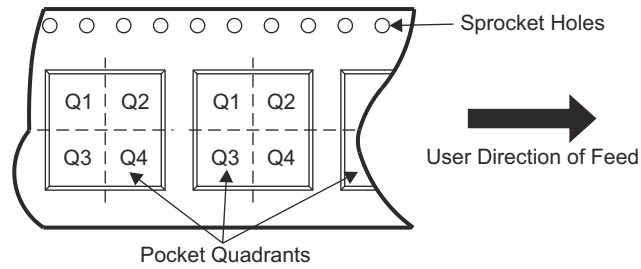
Orderable Device	Status ⁽¹⁾	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan ⁽²⁾	Lead/Ball Finish	MSL Peak Temp ⁽³⁾	Op Temp (°C)	Device Marking ^{(4) (5)}
CSD95430RRB	ACTIVE	QFN	RRB	41	2500	RoHS-Exempt & Green	CU NIPDAU/ Matte-Tin	Level-2-260C-1 YEAR	-55 to 150	95430RRB

- (1) The marketing status values are defined as follows:
ACTIVE: Product device recommended for new designs.
LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.
NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.
PRE_PROD Unannounced device, not in production, not available for mass market, nor on the web, samples not available.
PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.
OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.
- (2) Eco Plan - The planned eco-friendly classification: Pb-Free (RoHS), Pb-Free (RoHS Exempt), or Green (RoHS & no Sb/Br) - please check <http://www.ti.com/productcontent> for the latest availability information and additional product content details.
TBD: The Pb-Free/Green conversion plan has not been defined.
Pb-Free (RoHS): TI's terms "Lead-Free" or "Pb-Free" mean semiconductor products that are compatible with the current RoHS requirements for all 6 substances, including the requirement that lead not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, TI Pb-Free products are suitable for use in specified lead-free processes.
Pb-Free (RoHS Exempt): This component has a RoHS exemption for either 1) lead-based flip-chip solder bumps used between the die and package, or 2) lead-based die adhesive used between the die and leadframe. The component is otherwise considered Pb-Free (RoHS compatible) as defined above.
Green (RoHS & no Sb/Br): TI defines "Green" to mean Pb-Free (RoHS compatible), and free of Bromine (Br) and Antimony (Sb) based flame retardants (Br or Sb do not exceed 0.1% by weight in homogeneous material)
- (3) MSL, Peak Temp. -- The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.
- (4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device
- (5) Multiple Device markings will be inside parentheses. Only on Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.
Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.
 In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

6.2 Tape and Reel Information

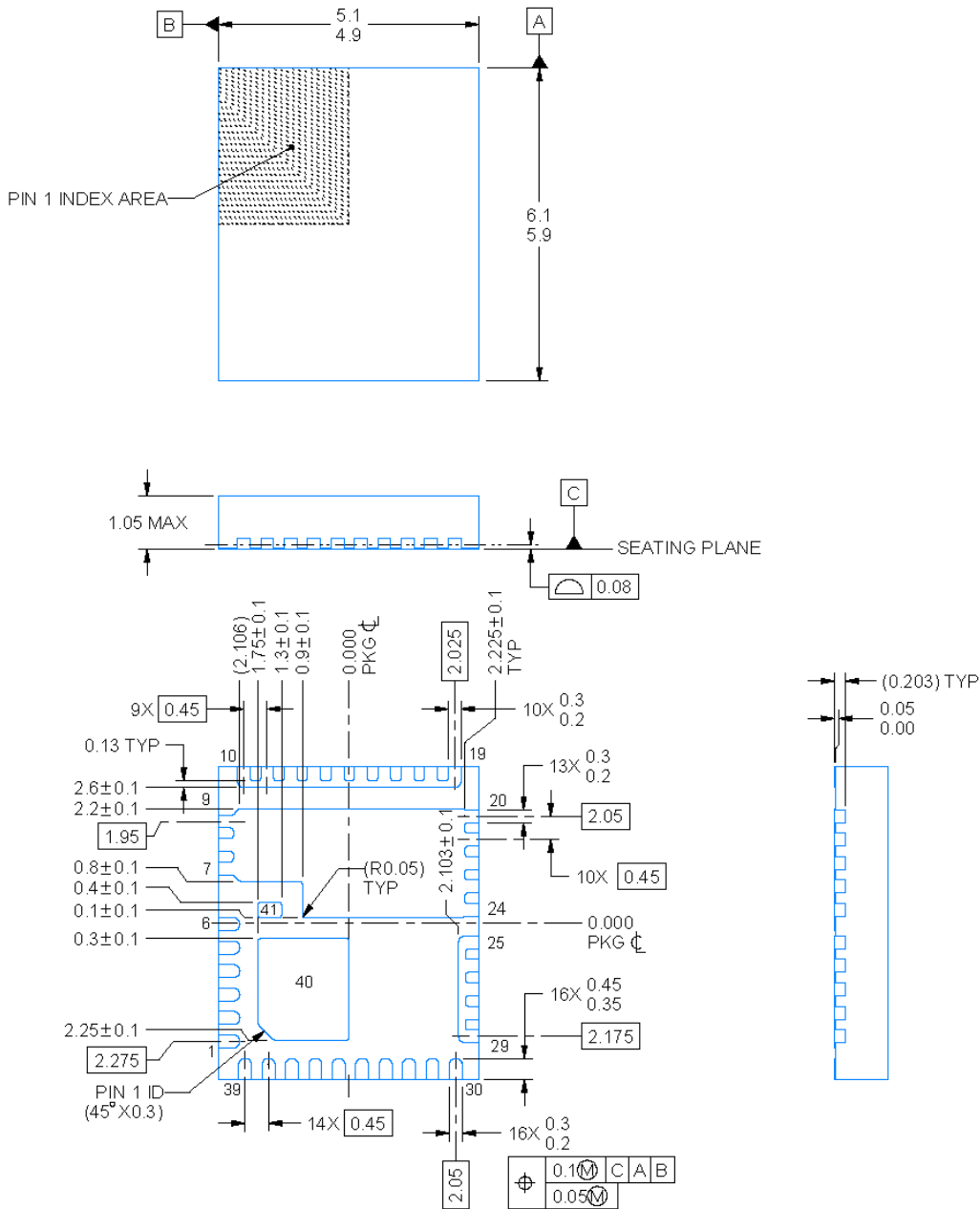


QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
CSD95430RRB	QFN	RRB	41	2500	330	12.4	5.30	6.30	1.20	8.00	12.0	Q1

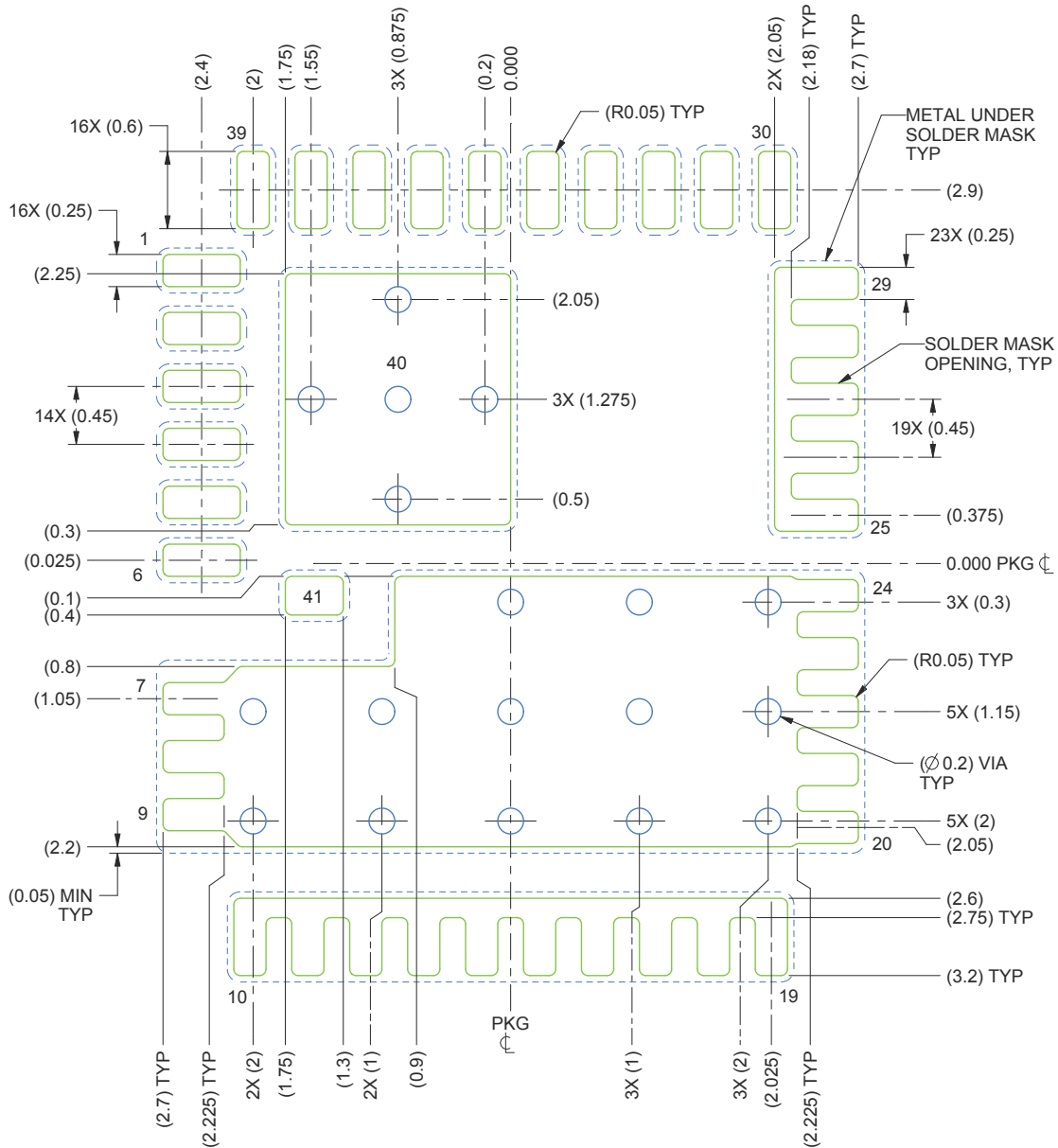
6.3 Mechanical Drawing



4224073/C 10/2018

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pads must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.

6.4 Recommended PCB Land Pattern

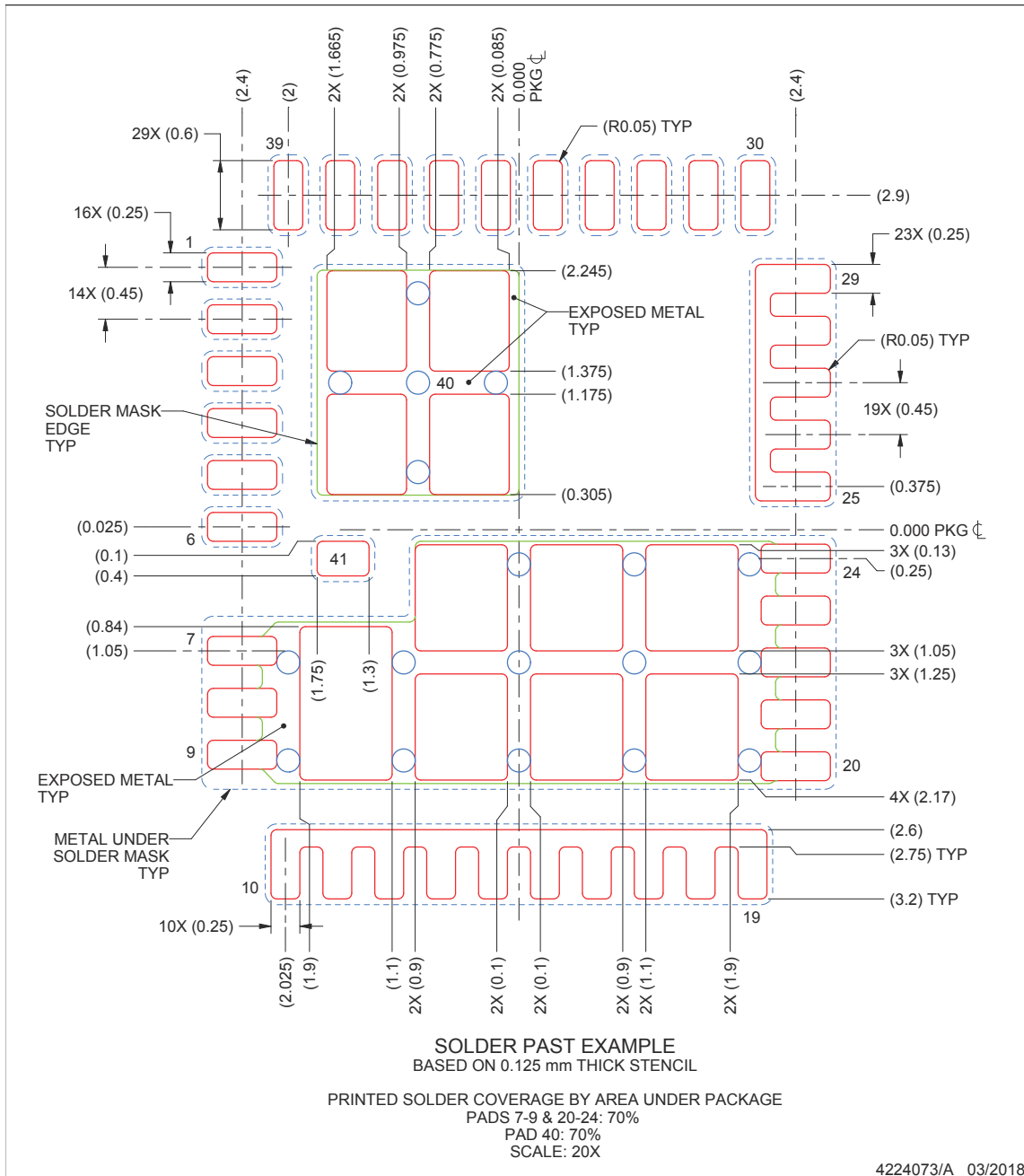


LAND PATTERN EXAMPLE
 SOLDER MASK DEFINED
 SCALE: 20X

4224073/A 03/2018

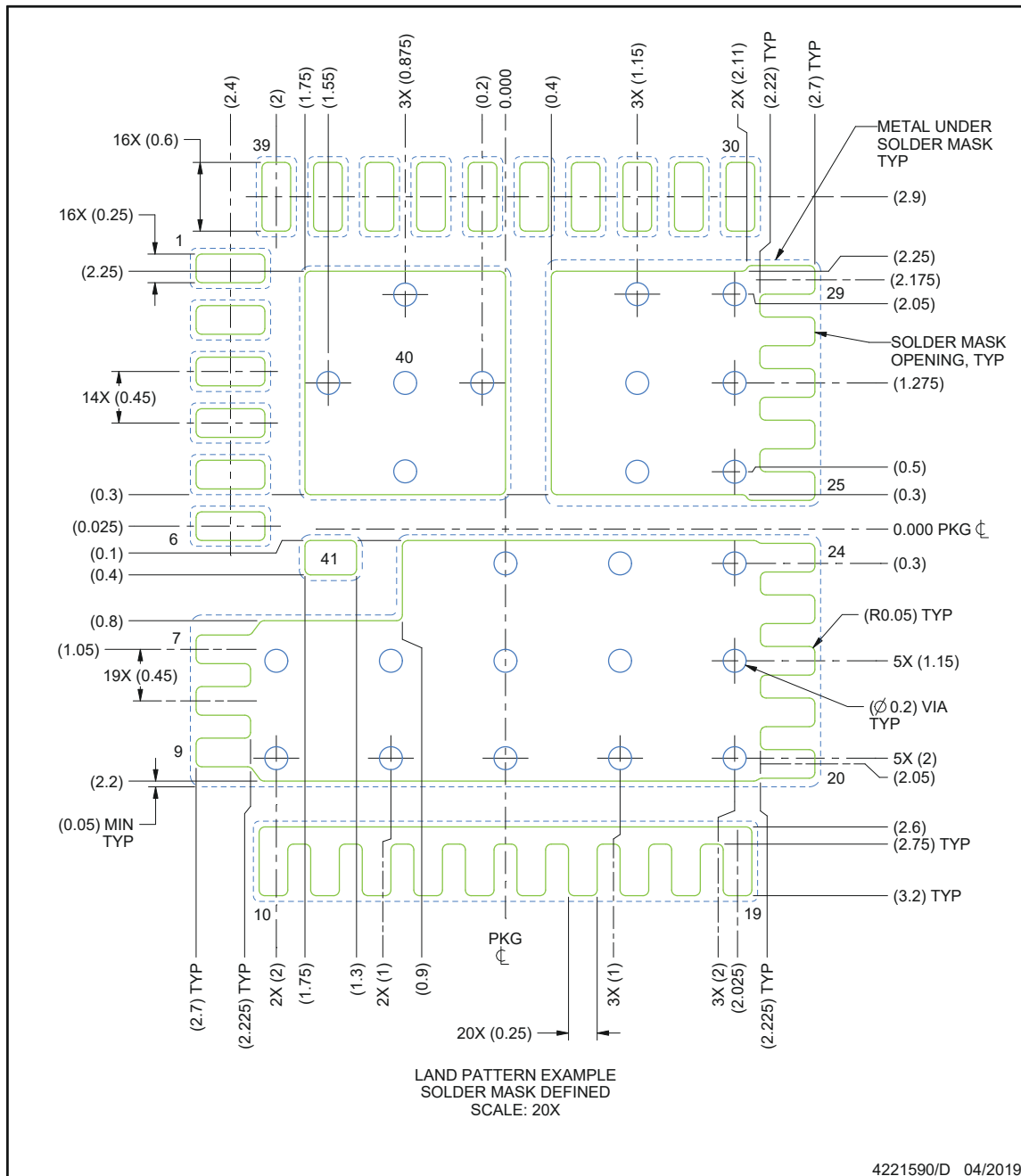
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This package is designed to be soldered to thermal pads on the board. For more information, see [QFN/SON PCB Attachment \(SLUA271\)](#).

6.5 Recommended Stencil Opening



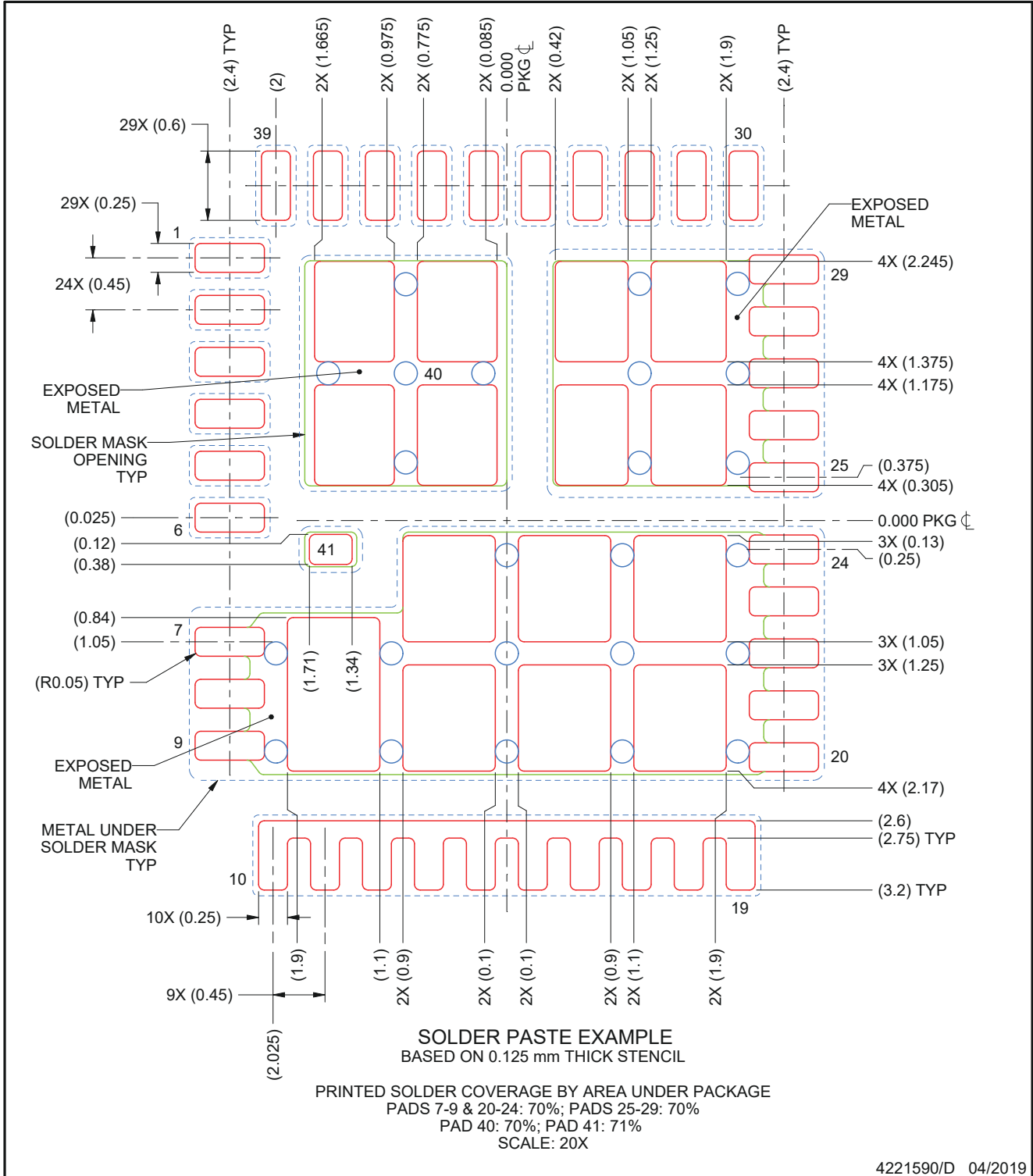
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

6.6 Alternate Industry Standard Compatible PCB Land Pattern



1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

6.7 Alternate Industry Standard Compatible Stencil Opening



重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated